

HP BOND

5660-71



Produktinfo Lim- og fugemasse

Type Annet

Produsent Staloc

Temperatur min. °C +5

Temperatur maks. °C +60

Beskrivelse STALOC HPBOND lim og fugemasse er et revolusjonerende limsystem med utmerkede strekkegenskaper, rask herdehastighet og høy mekanisk vedheft. Det er egnet for alle limingsprosesser som krever et resultat med høy ytelse og pålitelighet, selv under utfordrende omstendigheter. Produktets spesielle sammensetning og den utmerkede temperaturbestandigheten tillater pulverbelegg av limbindingen.

Artikkelnr.

Farge

56607142

Hvit

56607143

Sort

56607125

Grå